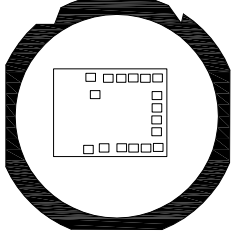

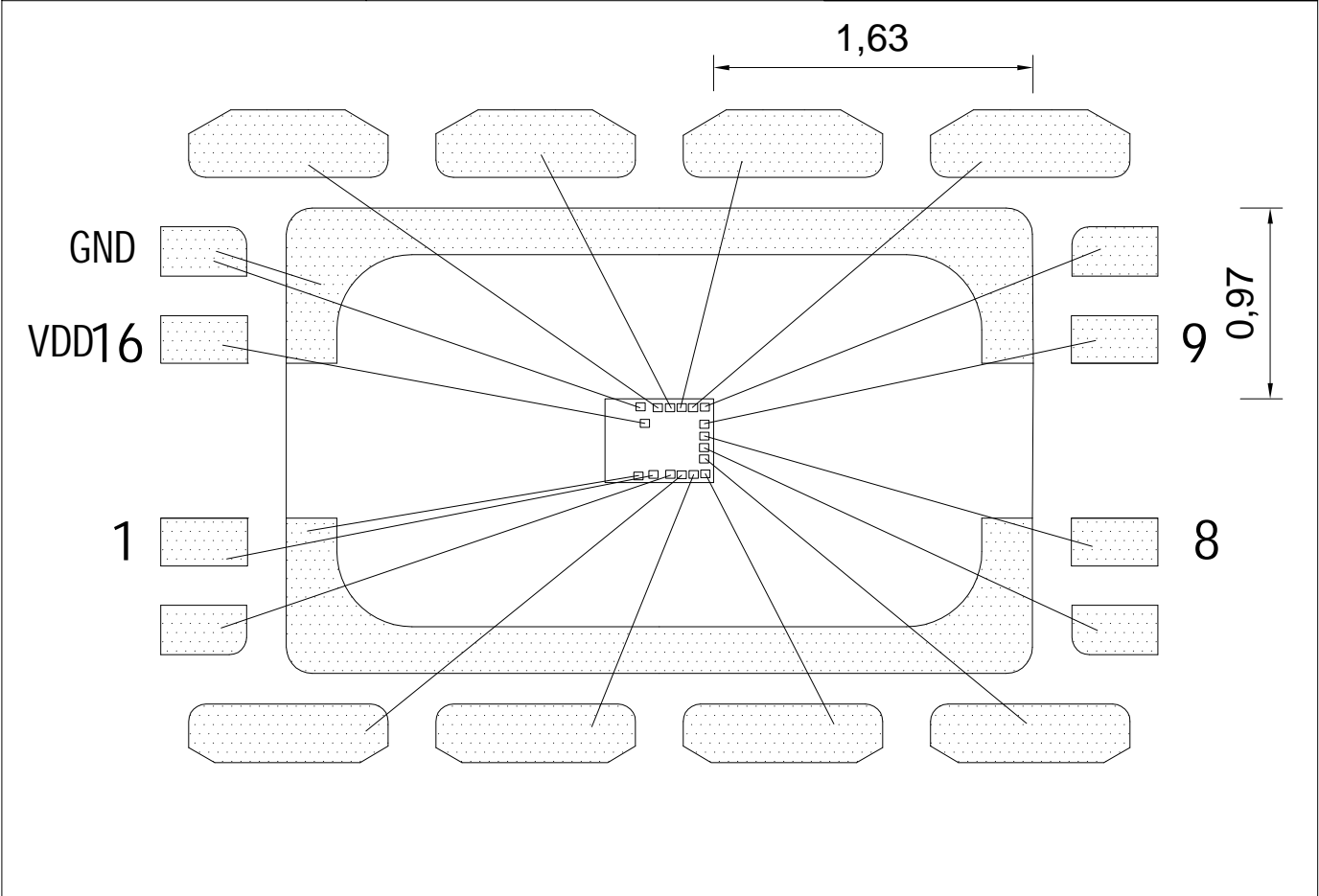


江苏芯丰集成电路封装压焊图		图号: 314BD001	版本	A.0
贴片方向（芯片与片环方向示意图） 	框架传输进料方向 第一个孔为椭圆孔 			
		备注及特殊要求（Remark&Special Instruction）		



顶针		点胶方式	
单顶针	多顶针	点胶	画胶
	/		/
产品型号 (Product Type):		HS2303-P	
芯片名称 (Die Name):		HS5122	
芯片尺寸: (Die Size):		0.5548×0.4332mm	
封装形式 (Package Type):		SOP16L(9.9×3.9×1.4e=1.27)	
引线框 (Lead Frame):		SOP16L(12R)(94×150)	
L/F电镀方式 (L/F Plating Type):		雾锡	
晶圆尺寸 (Wafer Size):		/	
吸嘴 (suction nozzle)		RR10×10	
拟制 Prepared by		钱培丽 2022.6.8	
线材直径 (Wire Diameter):		银合金线0.8mil	
压焊点尺寸 (Pad Opening):		50.35×50.35um	
最小压焊间距 (Min Pitch):		59.85um	
先焊线 (Wire Bond Start):		PIN15	
焊线总数 (Quantity of Wire):		18	
最长线长(Length of longest Wire):		2.42mm	
顶层铝厚 (Top Al Thickness):		1um(3层)	
切割道 (Cutting Way)		60um	
芯片减薄厚度 (Chip thinning thickness)		220±10um	
装片胶 (Epoxy)		首选	9246LB5(导电胶)
塑封料 (Molding Compound)		备选	S610C(导电胶)
RF 芯片		首选	GR710GN
LOW-K芯片		备选	/
CUP/BOAC		<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
RF 芯片		<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
LOW-K芯片		<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
审核 Checked by			
批准 Approved by			